

高密度ビルドアッププリント基板

配線設計からプリント基板製造、部品実装まで一貫したソリューションを同一サイト内でご提供

ベトナムで試作から量産まで一貫生産

ASEAN地域の中央に位置し、日本を含めたアジア各国へ毎日工場内通関し翌日配達も可能です。

<工場概要>

製造能力	基板	30,000m ² /月
	実装	2億チップ/月
床面積	基板製造	25,000m ²
	部品実装	16,000m ²



FICT VIETNAM COMPANY LIMITED



高信頼性プリント基板技術

Multi Via 技術により、高密度配線を実現

<主な仕様>

ビルドアップ	～5-X-5(X:2～10)
ピアメニュー	フィールド・ピア、スタックド・ピア構造他
狭ピッチ化	0.3mmピッチCSP対応
板厚薄型化	0.30mm(6層)および0.58mm(10層)対応
その他	貫通・貼り合わせ基板(4層～20層で対応可能)



全層IVH基板
12層(5-2-5)



貼り合わせ基板
8層(2+4+2)

最新鋭設備と高い技術力により高密度部品実装を実現

- 狭ピッチ部品実装に対応
- 鉛フリーおよびハロゲンフリー実装に対応
- 24時間ノンストップ稼働

CHIP	SSOP	SQFP	BGA/CSP
0402	0.4mm Pitch	0.4mm Pitch	0.4mm Pitch



高速チップマウンタ

製品事例

エンジン ECU・ADAS・インフォテインメント
高機能デジタルカメラ・プロジェクター
タブレット・スマートフォン
ノートパソコン

